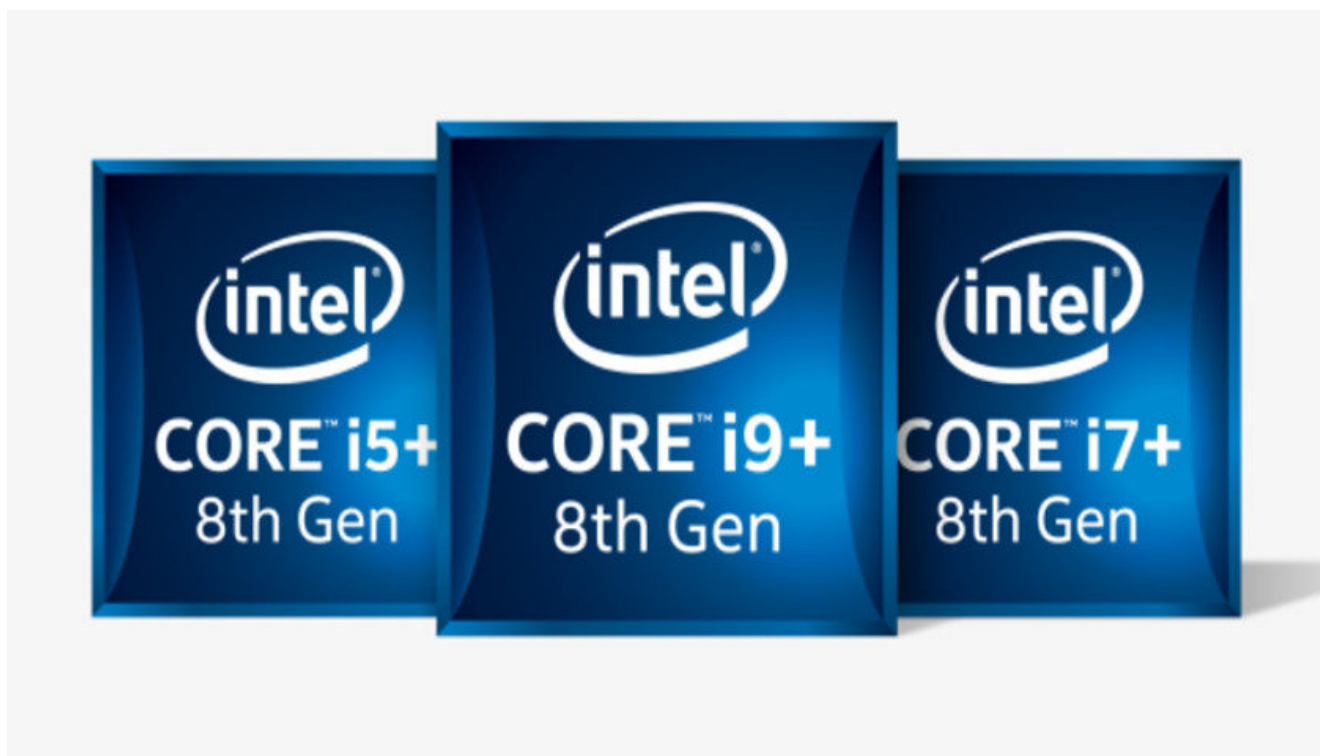


Estas imágenes se corresponden con el Core i3-8121U de Intel, fabricado a 10 nm



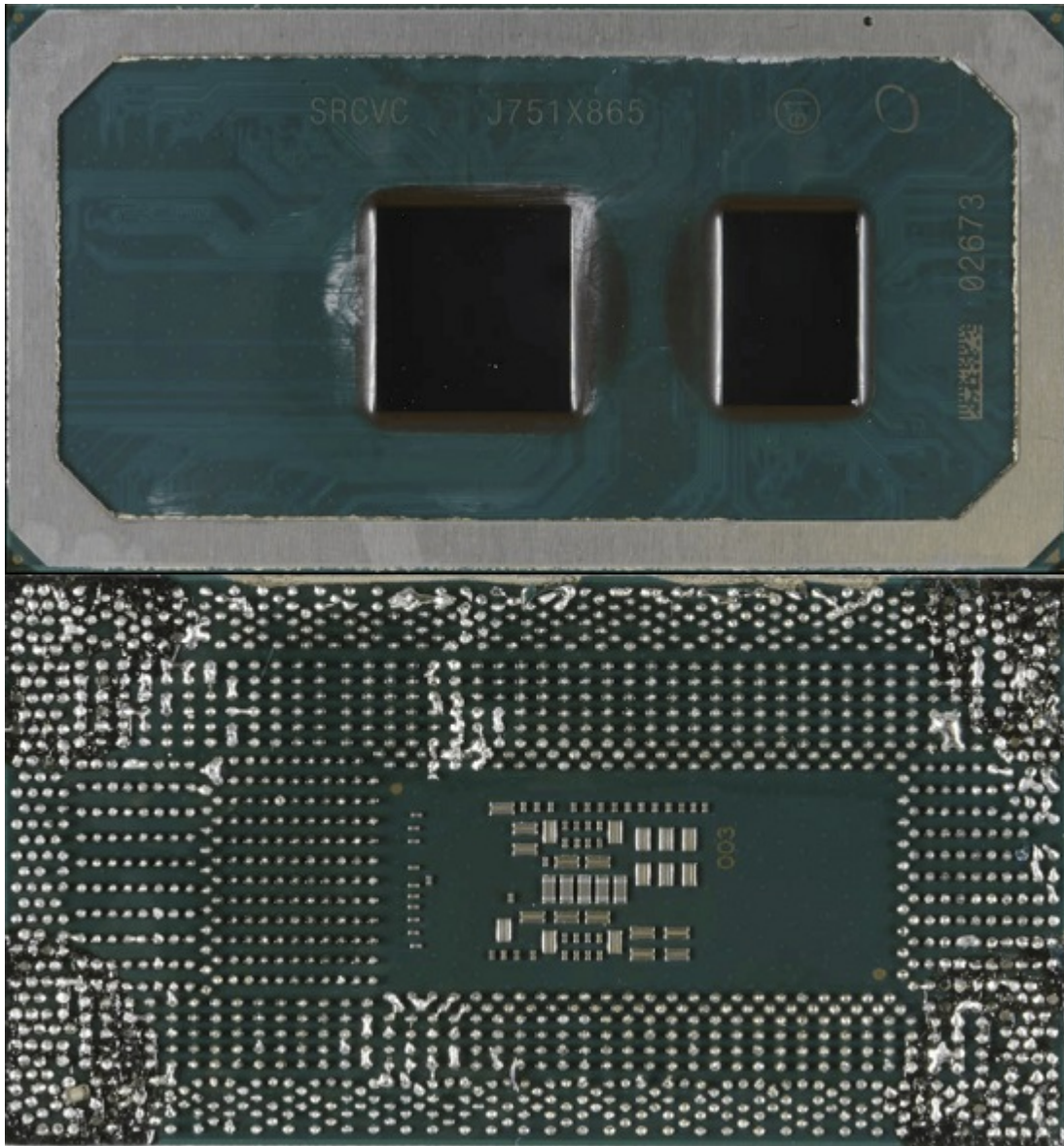
Intel ha retrasado a 2019 la mayor parte de la producción de chips con una litografía de 10 nm debido a diversos problemas presentados durante la producción. Pero eso no significa que este año no aparezca algún modelo concreto, y de momento está el Core i3-8130U o el Core i3-8121U para dispositivos móviles de bajo consumo (Cannon Lake U). En *Tech Insights* han desmontado el portátil de Lenovo (IdeaPad 330) que lo incluye para tener un vistazo de cerca del procesador.

Esta generación cuenta con 100.8 millones de transistores por mm^2 , lo que supone un aumento del 170 % del número de transistores por milímetro cuadrado con respecto al proceso de fabricación a 14 nm, también gracias a que Intel utiliza la

tecnología de hiperescalado. Utiliza igualmente tecnología FinFet, con una distancia entre puertas que pasa de 70 nm a 54 nm, y la distancia entre las dos capas de metal pasa de 52 nm a 36 nm.

Lo que resulta curioso de esto es que el tamaño del paquete es similar al de los Kaby Lake U, que es de 42 mm × 24 mm. En este empaquetado, como en todos los de la serie U, incluyen la pastilla del procesador en sí con su unidad gráfica integrada –los GT3 incluyen además otro adyacente para la unidad gráfica–, y el otro es el chipset ya que actúan como sistemas en chip –unidad gráfica, unidad de procesamiento y conectividad en un solo empaquetado–.

Por lo demás no hay muchas novedades. Las imágenes muestran la parte inferior desoldada al ser un paquete tipo BGA –matriz de rejilla de bolas, pequeñas bolitas dispuestas para su soldado directamente a placa base–. Lo que no está claro es si esa mayor densidad de transistores, al mantener tamaños de chips similares, se va a traducir en un aumento sustancial de potencia –que me imagino que sí–.



Fuente: geektopia.